

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

泰晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话调研）
参与单位名称及人员姓名	天风证券 张健 平安基金 翟森 英睿投资 陈曦 平安基金 季清斌 长隼资本 龙娴 交银施罗德 郭斐 兴银基金 高鹏 大成基金 施展 万联证券 黄超 九泰基金 谭绍杰 万联证券 高翔 荷和投资 李愚 宏鼎财富 李先明 昊晟投资 吕露 喜世润投资 郑捷 富兰克林邓普顿 孙通 名禹资管 王龙 东证融汇 于青青 聚鸣投资 蔡成吉 东海证券 洪汇 汇利资管 张运昌 华安财保 李阳 普尔投资 马国庆 承珞投资 胡慎 前海开源 庞黛儿 财通资管 黎来论 安信证券 计哲飞 源乘投资 刘建忠
时间	2021年01月28日 16:00-17:00
地点	董秘办公室
上市公司接待人员姓名	泰晶科技董事会秘书 黄晓辉 泰晶科技董秘办主任 刘剑

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、业绩预增公告情况介绍：</p> <p>1) 2020 年公司业绩实现跨越增长，第四季度净利润环比及同比大幅增长，同时 12 月单月主营产品毛利率得到提升，行业回暖景气度回升；</p> <p>2) 受疫情影响，公司上半年业绩出现下滑，主要系身处疫情严重地带，2020 年二季度公司生产经营才逐步恢复；</p> <p>3) 公司加大高端产品投放力度，整体产品结构不断优化。2020 年，公司片式产品产值不断提高，光刻工艺小尺寸 K3215 及以下产品占比每季度均在提升。MHz 高频 M2520、M2016 小型号、T2520 热敏产品等产量及比重同比提升；</p> <p>4) 下游优质客户导入方面，2020 年比较有代表性的 TSX 热敏 38.4MHz2016/1612 通过高通骁龙系列智能手机平台认证许可；TSX 19.2MHz、38.4MHz 热敏晶体、2520/2016 晶体导入主流通讯模组厂商；26MHz2520/2016 晶体通过优质方案商 Cat1 平台认证、Wifi 平台批量供货 40MHz3225 、48MHz2016；wifi 6 平台对应 48MHz、96MHz2016 晶体。另受到网通、IoT 模块、智能设备、手机、电子标签、PC、平板等 5G 场景应用拉动，国内国际大客户实现加速导入。</p> <p>5) 部分产品供不应求，整个行业和公司产品销售价格上涨。去年公司产品多次涨价，部分产品提价 20%-50%，特别是目前市场需求量大，国内独家可供应的半导体光刻工艺小尺寸系列产品；</p> <p>6) 限制性股票摊销小额费用，政府补助和转让泰卓电子股权等非经损益同比增加。</p> <p>二、公司业务进展：</p> <p>1) 产品结构上，公司实现产品型号全覆盖，K 系列具备绝对优势，M 系列小尺寸、高基频、热敏 T 系列产品产能提升，布局有源振荡器 TCXO；</p>
----------------------	--

2) 行业发展上, 对未来市场发展有信心, 市场空间比预测的要大, 目前感受到国产替代带来的积极变化, 给我们带来了前所未有的机遇, 泰晶与全球优秀企业同台竞技;

3) 技术应用上, 在技术沉淀方面, 公司深耕半导体光刻工艺十一年, 具备先发优势, 核心技术应用日益成熟, 实现了 MEMS 工艺在晶振上的产业化, 开始享受光刻工艺技术红利;

4) 客户扩展上, 公司在优质客户持续导入的同时, 也积极调整销售策略, 制定以服务为导向的大客户战略;

5) 人才激励上, 年底成功完成股票激励首次授予, 健全激励机制、调动员工积极性;

6) 定增方面, 公司目前已拿到证监会批文, 募投两个项目和补流, 公司已使用自有资金投入到项目建设中。

三、问答环节:

1、晶振行业供需是什么样的状态?

答: 从全球市场发展格局看, 日系部分产品产能逐步由大陆及中国台湾承接。根据 CS&A 日本压电水晶协会数据, 中国大陆市场份额从 2011 年的 4.8% 到 2017 年的 10.1%, 随着中国大陆公司近年来注重研发, 新产品开发加快, 高端产品相继推出, 大陆晶振市场占有率呈逐年加快上升的趋势。

受疫情影响, 海外厂商部分停产市场缺货。高端消费类产品爆发也是一个大的因素, 如高端 TWS 蓝牙耳机出货量增加, 海外同行厂家侧重 1612/1610 小尺寸, 造成 2520/2016 等产能不足, 而大陆厂家在 2520/2016 等尺寸逐步扩产上量。

综合来看, 短期部分产品供不应求, 长期国产替代和下游丰富的场景需求支持行业景气度。

2、公司中高端产品收入占比大概多少?

答: 从 19 年财报数据来看, 公司 SMD 片式系列产品产值占比

从去年的 65% 又有较大提升。其中 K 系列产品提升明显, M2520、2016、热敏系列产品占比增长。

3、公司此前几次产品涨价的具体情况 & 需求场景是怎样的？

答：2020 年，晶振行业部分产品供不应求，产品局部涨价。公司产品涨价也受行业整体要素影响。去年 2 月份，在产品供给紧张情况下，进行了第一轮涨价；8 月份和 10 月份，同时受原材料价格上涨影响，订单增多，人员不足，招工及用工成本提高，公司对于更低功耗、超小型、高品质产品研发投入力度的加大，K3215、K2012 和热敏晶体产品价格提价；11 月份新订单执行新价格，公司部分产品供不应求，停止接单以保障优质客户供应。具体应用场景，CAT 1、NB-IOT、智能穿戴、TWS、智能网关、电子标签、笔电需求强劲，同时稳定性要求较高的 5G 智能手机场景需求较高。

4、公司未来两到三年产能分布和规划是怎样的？

答：公司目前共有 5 条主要生产产线，包括 DIP 封装方式音叉晶体谐振器（TF104、TF 206、TF 308-TF 系列）、SMD 片式音叉晶体谐振器（K3215、K 2012、K 1610-K 系列）、SMD 片式高频晶体谐振器（M3225、M 2520、M 2016、M 1612、M 1008）、SMD 片式内置热敏电阻谐振器（T2520、T2016、T1612-T 系列）、SMD 片式温补 TCXO（TC2520、TC2016、TC1612-TC 系列），另有占比小但产量价格较稳定的 49S/49S-SMD、M8 产品等，产品线丰富。2020 年公司在高端产品结构上进一步优化，未来两年将加大片式 K 系列、SMD 片式高频小型号、热敏 TSX 系列和 TCXO 系列高附加值产品产能。

5、上游原材料涨价情况如何？基座是否会继续上涨？

答：晶振主要成本在晶片，占比较大，公司目前实现自主研发、

自主供应。其他原材料成本主要系基座和贵金属（镀金工艺），有适当涨价。部分产品基座公司自己生产，部分由供应商提供，泰晶是其优质的长期合作伙伴，价格控制在合理范围内。

6、晶振未来 5-10 年，市场空间和增速如何？

答：据 CS&A 数据，2019 年全球晶振市场规模在 34 亿美元左右，但我们认为是不完全统计。考虑关口数据及下游应用空间，全球晶振市场整体规模要大得多。中国产业信息网数据显示，预测 2021 年全球晶振市场需求量达 1980 亿只并将持续增长。目前行业景气度在复苏，未来国内增量空间提升。从全球格局来看，日本部分产品产能逐步出清，大陆凭借技术优势承接消化产能。中国全球市场份额大概在 10%左右，未来增长空间仍比较大。

7、晶振技术难点和壁垒在哪方面？

答：晶振难点在晶片开发，当晶振的基频达到一定程度，传统加工方式无法完成，需要光刻工艺来实现，小尺寸也需要光刻工艺提高产品的一致性和性能品质。公司在半导体光刻工艺产品的开发、设备、工艺技术等已持续投入了十多年，从 MEMS 整个工艺过程来看，完成需要 40 多道工序，光刻只是其中一道工序。公司通过十余年发展和技术沉淀，在 Wafer 晶片、晶圆切割、晶片表面处理、镀膜、涂胶、激光微加工、离子刻蚀工艺等重要环节积累了丰富经验，形成了专有的双面曝光技术、等离子刻蚀技术、微纳米加工技术，部分核心智能装备自主开发，在国内率先实现了半导体光刻工艺应用的产业化。

8、汽车电子板块晶振需求如何？公司是否取得供应商认证？

答：车载晶振对稳定性、可靠性要求非常高。智能汽车相比传统汽车，晶振需求呈量级增加，单台车需求大概从 30 颗提升到

	70 颗，市场空间比较大。同时汽车厂商对品牌和质量控制非常严格，公司具备的先进生产技术优势，生产高品质、高稳定性、高可靠性产品可承接大客户要求。目前已与国际友商在汽车电子晶振领域有合作和技术交流，公司已取得汽车领域产品认证并有供货。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 01 月 28 日